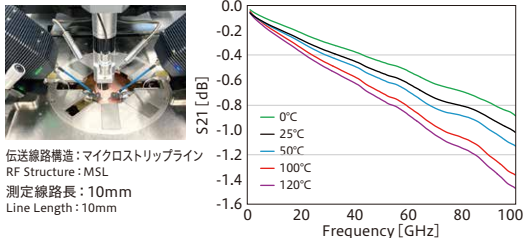


# 計測・評価

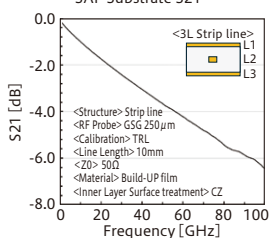
## Measurement-Evaluation-Reliability Test

### 伝送線路計測 Transmission Line S-Parameter Measurement

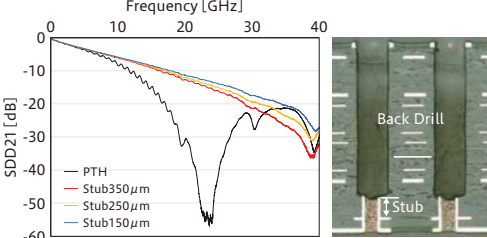
環境温度毎 Sパラメータ挿入損失 S21 by Temp.



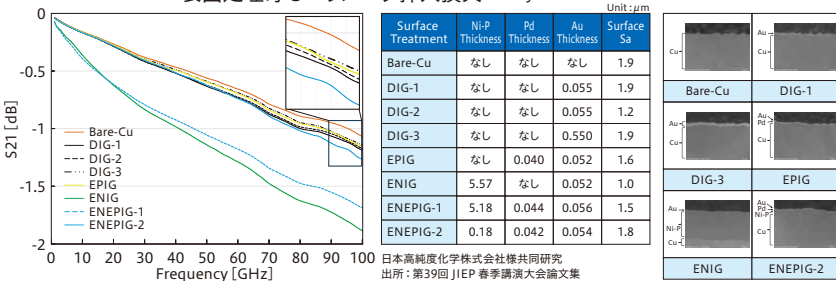
SAP基板 Sパラメータ挿入損失 SAP Substrate S21



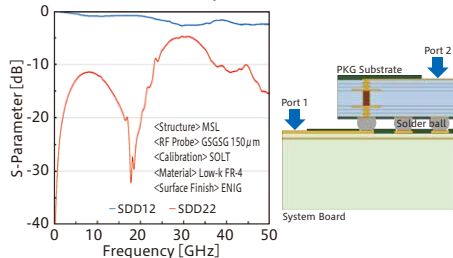
バックドリル Sパラメータ挿入損失 SDD21 by Stub Length



表面処理毎 Sパラメータ挿入損失 S21 by Surface Treatment

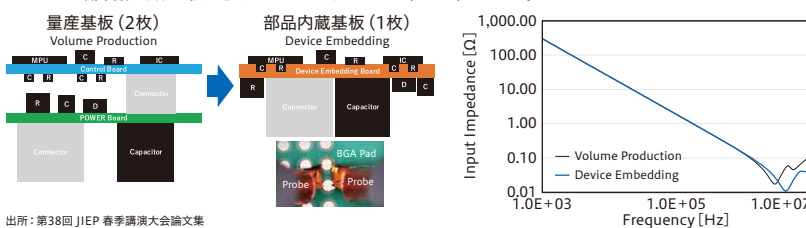


サブストレート実装構造 Sパラメータ S-Parameter from System Board to Substrate



### 電源インピーダンス計測 Input Impedance Measurement

部品内蔵基板 電源インピーダンス Input Impedance by Embedded Device Substrate



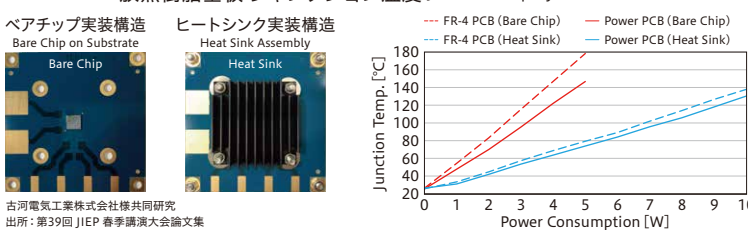
### 基板小型化 PCB Miniaturization

	表面実装基板 SMT PCB	部品内蔵基板 Embedded Device PCB	AMインターポーザー Additively Manufactured Interposer
外観 Overview			
内蔵部品厚み Device Thickness	—	0.5mm	2mm
部品実装面数 SMT Layers	4面	3面	6面 (拡張可能) 6 Layers (Expandable)
効果 Effect	リファレンス Reference	厚み34%減 Height -34%	面積33%減 Area -33%

株式会社FUJII様共同研究

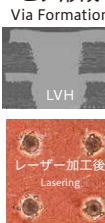
### 半導体チップ温度計測 IC Temperature Measurement

放熱樹脂基板 ジャンクション温度 Junction Temp. by Power PCB



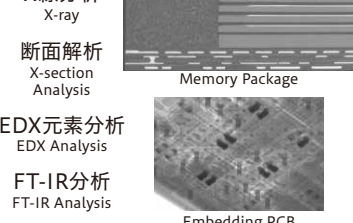
### 加工条件評価 Process Condition

ビア形成  
Via Formation



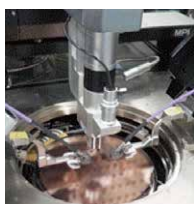
### 基板分析 PCB Analysis

X線分析  
X-ray



### ウエハー/ガラスサブストレート測定 Wafer/Glass Substrate Measurement

オンウエハーRF測定  
On-Wafer RF Measurement

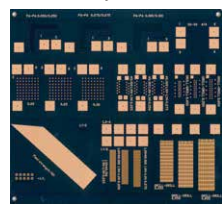


ガラスサブストレート材料測定  
Glass Material Characteristic

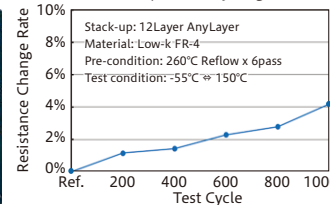


### 信頼性試験 Reliability Test

信頼性試験基板  
Reliability Test Board



冷熱衝撃試験  
Temperature Cycling Test



イオンマイグレーション試験  
Temperature Humidity Bias Test

